

江苏捷捷微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）截至2020年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

自2017年首次公开发行股份并在创业板上市至2020年12月31日止，本公司共有两次募集资金。

（一）前次募集资金到位情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]240号”文核准，并经深圳证券交易所《关于江苏捷捷微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]163号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,360万股，发行价格27.63元/股，募集资金总额为65,206.80万元，扣除发行费用4,961.94万元之后，募集资金净额为60,244.86万元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月9日出具了“瑞华验字【2017】48450001号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2020年12月31日，2017年首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截至2020年12月31日余额
兴业银行股份有限公司启东支行	408870100100016365	186,960,000.00	-
招商银行股份有限公司启东支行	513902115310666	157,743,000.00	-
中国建设银行股份有限公司启东支行	32050164763600000248	45,000,000.00	-
江苏银行股份有限公司启东支行	50370188000173779	212,745,600.00	-

合计		602,448,600.00	-
----	--	----------------	---

2017年6月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，将“功率半导体器件生产线建设项目”及“半导体防护器件生产线建设项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司捷捷半导体有限公司（以下简称“捷捷半导体”）；实施地点由启东近海盐场滨海工业区变更为江苏南通市苏通科技产业园。2017年6月12日，公司将兴业银行股份有限公司启东支行募集资金专户（408870100100016365）中收到的募资款186,960,000.00元全额转入至捷捷半导体开立的募集资金专户兴业银行股份有限公司启东支行（408870100100019864）。2019年4月4日，捷捷半导体在兴业银行股份有限公司启东支行开立的“功率半导体器件生产线建设项目”募集资金专户注销，账户余款147.63元转入捷捷半导体的其他账户。

2017年6月27日，公司在江苏银行股份有限公司启东支行开立的“补充营运资金项目”募集资金专户注销，账户余款182,035.55元转入公司其他账户。

2017年6月12日，公司将招商银行股份有限公司启东支行募集资金专户（513902115310666）中收到的募资款157,743,000.00元全额转入至捷捷半导体开立的募集资金专户兴业银行股份有限公司启东支行（513903607410611）。2019年12月6日，捷捷半导体在招商银行股份有限公司启东支行开立的“半导体防护器件生产线建设项目”募集资金专户注销，账户余款70,398.75元转入捷捷半导体的其他账户。

2019年12月6日，公司在中国建设银行股份有限公司启东支行开立的“工程技术研究中心项目”募集资金专户注销，账户余款233,666.52元转入公司其他账户。

截至2020年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户已全部注销。

2、2019年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监“证监许可[2019]2289号”文核准，公司向上海北信瑞丰资产管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、江苏隼泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）、周雪钦、财通基金管理有限公司5名特定投资者非公开发行人民币普通股3,566.10万股，发行价格为每股人民币21.18元，募集资金总额为75,530.00万元，扣除与发行有关的费用2,046.82万元（含税），实际募集资金净额为

73,483.18 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 24 日出具了“会验字[2019]8351 号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2020 年 12 月 31 日，2019 年非公开发行股票募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	截至 2020 年 12 月 31 日余额
江苏银行股份有限公司南通分行	50370188000226222	531,010,500.00	63,827,166.20
兴业银行股份有限公司启东支行	408870100100050983	190,122,200.00	131,180,381.45
中国工商银行股份有限公司启东支行	1111629929100643895	13,699,057.55	-
合计		734,831,757.55	195,007,547.65

说明：公司已于 2020 年 1 月 16 日办理募集资金专户中国工商银行股份有限公司启东支行（1111629929100643895）的销户手续。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金余额为 0.00 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	602,448,600.00
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	604,078,946.22
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	1,934,559.12
减：专户销户转出金额	304,212.90
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	-

2、2019 年非公开发行股票募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金余额为 195,007,547.65 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	734,831,757.55
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	547,215,257.27
加：专户存储累计利息扣除手续费后余额	7,391,047.37

截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	195,007,547.65
-----------------------------	----------------

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

1、2017 年首次公开发行股票募集资金

本公司承诺投资 4 个项目为：功率半导体器件生产线建设项目、半导体防护器件生产线建设项目、工程技术研究中心项目、补充营运资金项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、2019 年非公开发行股票募集资金

本公司承诺投资 3 个项目为：电力电子器件生产线建设项目、捷捷半导体有限公司新型片式元器件及光电混合集成电路封测生产线建设项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 3。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，公司没有变更募集资金投资项目。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2017 年首次公开发行股票募集资金

(1) 功率半导体器件生产线建设项目差异说明：

功率半导体器件生产线建设项目实际投资总额 18,785.47 万元，较承诺投资金额 18,696.00 万元多 89.47 万元，原因系使用募集资金专户存储产生的银行利息收入。

(2) 半导体防护器件生产线建设项目差异说明：

半导体防护器件生产线建设项目实际投资总额 15,821.14 万元，较承诺投资金额 15,774.30 万元多 46.84 万元，原因系使用募集资金专户存储产生的银行利息收入。

(3) 工程技术研究中心项目差异说明：

工程技术研究中心项目实际投资总额 4,526.73 万元，较承诺投资金额 4,500.00 万元多 26.73 万元，原因系使用募集资金专户存储产生的银行利息收入。

(4) 补充流动资金项目差异说明：

补充流动资金项目实际投资总额 21,274.56 万元，与承诺投资金额 21,274.56 万元无差异。

2、2019 年非公开发行股票募集资金

(1) 电力电子器件生产线建设项目差异说明：

电力电子器件生产线建设项目实际投资总额 47,146.92 万元，较承诺投资金额 53,101.05 万元少 5,954.13 万元，主要原因系截至 2020 年 12 月 31 日，该项目仍处于投资建设阶段。

(2) 捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目差异说明：

捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目实际投资总额 6,204.70 万元，较承诺投资金额 19,012.22 万元少 12,807.52 万元，主要原因系截至 2020 年 12 月 31 日，该项目仍处于投资建设阶段。

(3) 补充流动资金项目差异说明：

补充流动资金项目实际投资总额 1,369.91 万元，与承诺投资金额 1,369.91 万元无差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、前次募集资金先期投入项目置换情况

(1) 2017 年首次公开发行股票募集资金

2017 年 6 月 5 日，公司第二届董事会第二十次会议，以及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计 19,432.22 万元，募集资金置换情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《江苏捷捷微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]48450012 号），具体情况如下：

序号	募投项目名称	承诺募集资金投资金额（万元）	自筹资金预先投入金额（万元）
1	功率半导体器件生产线建设项目	18,696.00	7,359.74
2	半导体防护器件生产线建设项目	15,774.30	10,616.38
3	工程技术研究中心项目	4,500.00	1,456.10
	合计	38,970.30	19,432.22

（2）2019 年非公开发行股票募集资金

2020 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第二十五次会议，以及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 27,062.45 万元，募集资金置换情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于江苏捷捷微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]216Z0008 号），具体情况如下：

序号	募投项目名称	承诺募集资金投资金额（万元）	自筹资金预先投入金额（万元）
1	电力电子器件生产线建设项目	53,101.05	23,897.70
2	捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目	19,012.22	3,164.75
	合计	72,113.27	27,062.45

（五）闲置募集资金情况说明

为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2020 年 1 月 8 日，经公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以协定存款、定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、2017年首次公开发行股票募集资金

2017年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、2019年非公开发行股票募集资金

2019年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

(三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

不适用。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

附件：

- 1、2017年首次募集资金使用情况对照表
- 2、2017年首次募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 3、2019年非公开发行募集资金使用情况对照表
- 4、2019年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2021年3月19日

附件 1:

2017 年首次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：						60,244.86	已累计使用募集资金总额：			60,407.89
变更用途的募集资金总额：							各年度使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额比例：							2017 年：			34,551.27
							2018 年：			9,785.63
							2019 年：			2,315.89
							2020 年：			-
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	功率半导体器件生产线建设项目	功率半导体器件生产线建设项目	18,696.00	18,696.00	18,785.47	18,696.00	18,696.00	18,785.47	89.47	2018 年 12 月
2	半导体防护器件生产线建设项目	半导体防护器件生产线建设项目	15,774.30	15,774.30	15,821.14	15,774.30	15,774.30	15,821.14	46.84	2017 年 12 月
3	工程技术研究中心项目	工程技术研究中心项目	4,500.00	4,500.00	4,526.73	4,500.00	4,500.00	4,526.73	26.73	2018 年 12 月
4	补充营运资金项	补充营运资金项目	21,274.56	21,274.56	21,274.56	21,274.56	21,274.56	21,274.56	-	不适用

	目									
	合计		60,244.86	60,244.86	60,407.89	60,244.86	60,244.86	60,407.89	163.03	

附件 2:

2017 年首次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
				2018 年	2019 年	2020 年度	累计实现效益	
序号	项目名称							
1	功率半导体器件生产线建设项目	39.42%	3,029.16	不适用	949.16	3,792.09	4,741.25	是
2	半导体防护器件生产线建设项目	111.29%	3,516.24	2,784.97	3,574.84	9,394.49	15,754.30	是
3	工程技术研究中心项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充营运资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

说明 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

说明 2：功率半导体器件生产线与半导体防护器件生产线承诺效益系均指年均利润总额。

说明 3：截至到 2020 年 12 月 31 日，功率半导体器件生产线建设项目累积投资金额 18,785.47 万元，投资进度为 100.48%。2019 年度，该项目实现营业收入为 5,559.66 万元，利润总额为 949.17 万元，净利润为 765.60 万元。2020 年度，该项目实现营业收入为 10,114.57 万元，利润总额为 3,792.09 万元，净利润为 3,252.38 万元。

说明 4：截至到 2020 年 12 月 31 日，半导体防护器件生产线建设项目累积投资金额 15,821.14 万元，投资进度为 100.30%。本项目于 2017 年底完成试生产，2018 年正式投产。2018 年，该项目实现营业收入为 19,459.23 万元，利润总额为 2,784.97 万元，净利 2,262.47 万元。2019 年度，该项目实现营业收入为 17,748.67 万元，利润总额为 3,574.84 万元，净利润为 2,883.47 万元。2020 年度，该项目实现营业收入为 27,117.31 万元，利润总额为 9,394.49 万元，净利润为 8,057.42 万元。

附件 3:

2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司

金额单位：

募集资金总额：			73,483.18			已累计使用募集资金总额：			54,721.53
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额比例：						2019 年：			27,062.45
						2020 年：			27,659.08
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	电力电子器件生产线建设项目	电力电子器件生产线建设项目	53,101.05	53,101.05	47,146.92	53,101.05	53,101.05	47,146.92	-5,954.13
2	捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目	捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目	19,012.22	19,012.22	6,204.70	19,012.22	19,012.22	6,204.70	-12,807.52
3	补充流动资金项目	补充流动资金项目	1,369.91	1,369.91	1,369.91	1,369.91	1,369.91	1,369.91	0.00
	合计		73,483.18	73,483.18	54,721.53	73,483.18	73,483.18	54,721.53	-18,761.65

附件 4:

2019 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日

编制单位：江苏捷捷微电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
				2018 年	2019 年	2020 年	累计实现效益	
序号	项目名称							
1	电力电子器件生产线建设项目	不适用	12,262.73	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目	不适用	4,592.43	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

说明 1：“电力电子器件生产线建设项目”截止至本报告期投资进度为 88.79%，尚未建设完成，在本报告期无法达成预计收益。

说明 2：“捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目”截止至本报告期投资进度为 32.64%，尚未建设完成，在本报告期无法达成预计收益。